

# 2009年上期決算説明会

2009年11月13日  
株式会社大阪チタニウムテクノロジー - ズ

## 目 次

---

1. 2009年度上期 決算実績
2. 2009年度 通期業績見通し
3. 足元の市場環境
4. 中期市場環境の展望

# 2009年度上期 決算実績

# 2009年度上期 決算業績

	08年度 上期実績	09年度 上期実績	増減	<参考> (百万円)	
				09年度上期 09/4予想	増減
売上高	27834	17352	10482	16600	+ 752
営業利益	9436	1863	7572	1200	+ 663
営業外損益	58	690	631	600	90
経常利益	9377	1173	8204	600	+ 573
当期純利益	5424	638	4785	300	+ 338

(為替レート)

(106円/\$)

(96円/\$) (10円/\$円高)

(95円/\$) (1円/\$円安)

## 09/4予想からの変化内容

(億円)

	内 容	影響額	
		売上高	営業利益
プラス 要因	・高純度チタン 及び 鉄鋼添加用 スポンジチタン	+ 7	+ 2
	・償却費(設備投資抑制)		+ 4
	・コスト合理化(補修費他)		+ 2
	計	+ 7	+ 8
マイナス 要因	・操業度(スポンジチタン減産強化)		2
	計		2
	合計	+ 7	+ 6

4

## B / Sの概要

「総資産」: 前年度末比 36億円の減 (09/3E 969 09/9E 933億円)



自己資本比率 09/3E 48.7 09/9E 49.7%

5

## C / Fの概要

(億円)

		09 / 上実績
	税前償却前利益	+ 68
	税支出	15
	その他	1
営業活動によるC / F		+ 52
	有形固定資産取得	130
	その他	1
投資活動によるC / F		131
	借入金増減	+ 100
	配当金	15
	リース債務返済	5
財務活動によるC / F		+ 80
現金及び現金同等物増減		+ 1
手許資金残高		09/3E 33      09/9E 34



## 09/4予想からの修正内容

(億円)

	内 容	影響額	
		売上高	営業利益
プラス 要因	・償却費(設備投資抑制)		+ 5
	・コスト合理化(補修費他)		+ 3
	計		+ 8
マイナス 要因	・数量構成	30	6
	・販売価格	7	7
	・為替レート(95円/\$ 93円/\$)	3	3
	・棚卸資産評価損(低価法)		11
	・他		2
	計	40	29
	合計	40	21

10

## 事業別売上高 及び 営業利益

(百万円)

	08年度 実 績	09年度 見通し	増減
チタン事業	3 6 2 0 5	1 8 4 0 0	1 7 8 0 5
半導体・高機能材料事業	1 5 8 8 3	1 3 1 0 0	2 7 8 3
売上高	5 2 0 8 8	3 1 5 0 0	2 0 5 8 8
チタン事業	8 9 9 3	2 2 0 0	1 1 1 9 3
半導体・高機能材料事業	5 7 0 0	3 2 0 0	2 5 0 0
営業利益	1 4 6 9 3	1 0 0 0	1 3 6 9 3

11

## 前年度(08)との対比

(億円)

	内 容	影響額	
		売上高	営業利益
数量構成 販売価格 為替レート 棚卸資産評価損 コスト	} スポンジチタンの販売環境悪化	132	74
		39	39
		7	5
		11	
	低価法適用(スポンジチタン)		11
	コスト合理化他 + 23、償却費 6		+ 17
チタン事業	計	178	112
数量構成 販売価格 為替レート コスト	多結晶シリコン増、高純度チタン他減 多結晶シリコン価格	4	7
		22	22
		2	2
		6	
	コスト合理化他 + 6		+ 6
半導体・高機能材料事業	計	28	25
	合計	206	137

12

(参考)

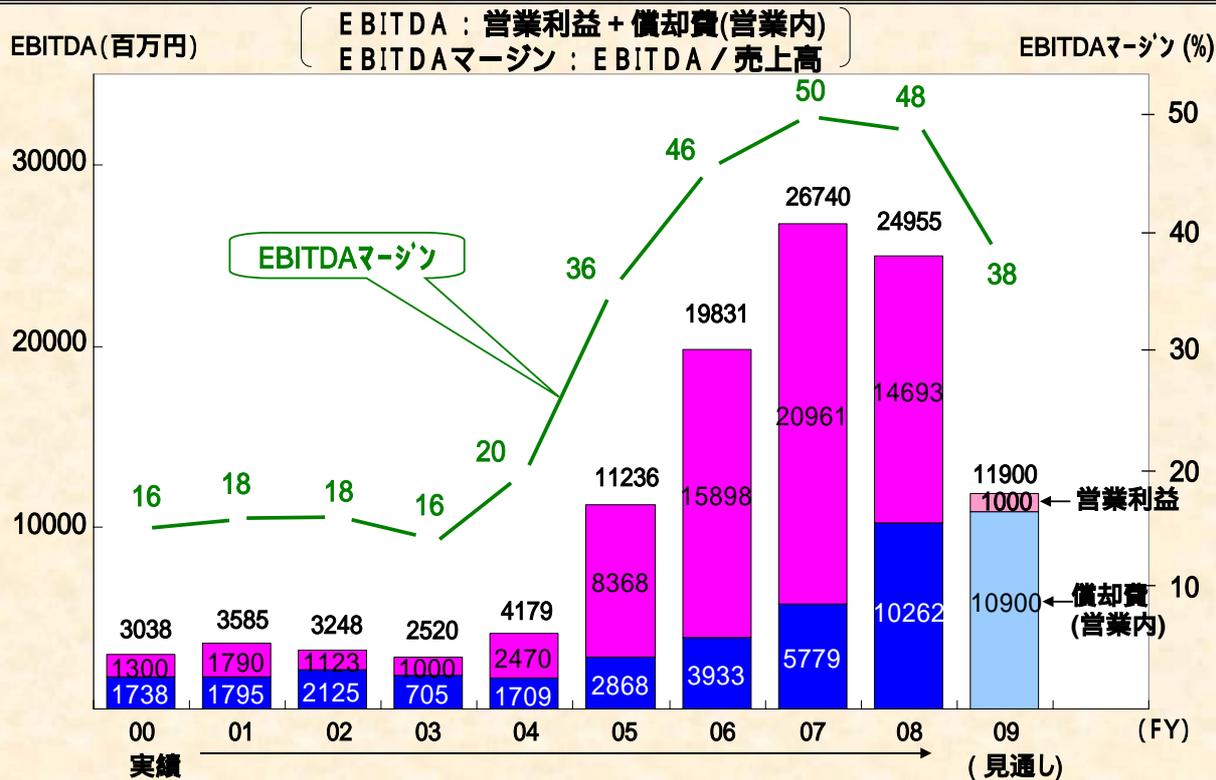
## 設備投資(土地除く)と償却費の水準



13

(参考)

# EBITDA 及び EBITDAマージン



\* EBITDA(イ-ビツデ-イ-イ-) : Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization

# 足元の市場環境

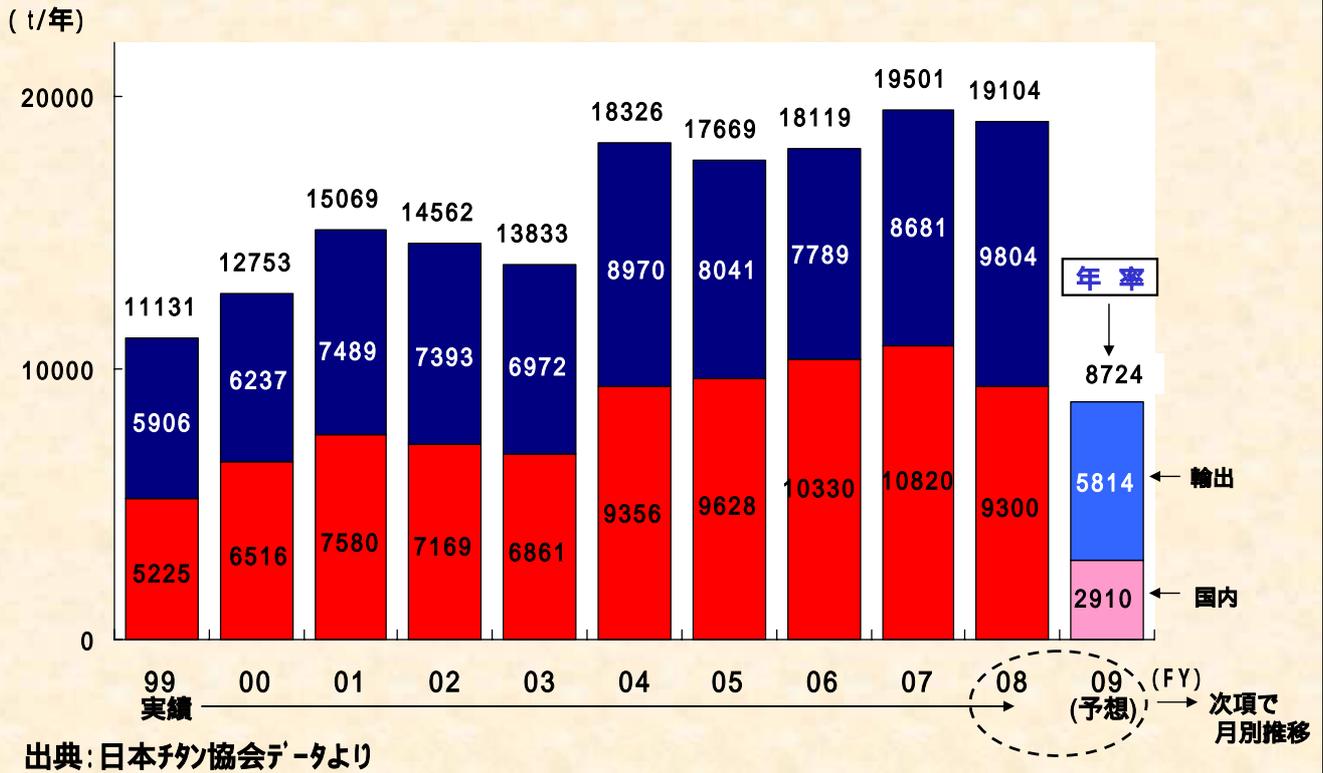
- (1) チタン事業
- (2) 半導体・高機能材料事業

# 足元の市場環境

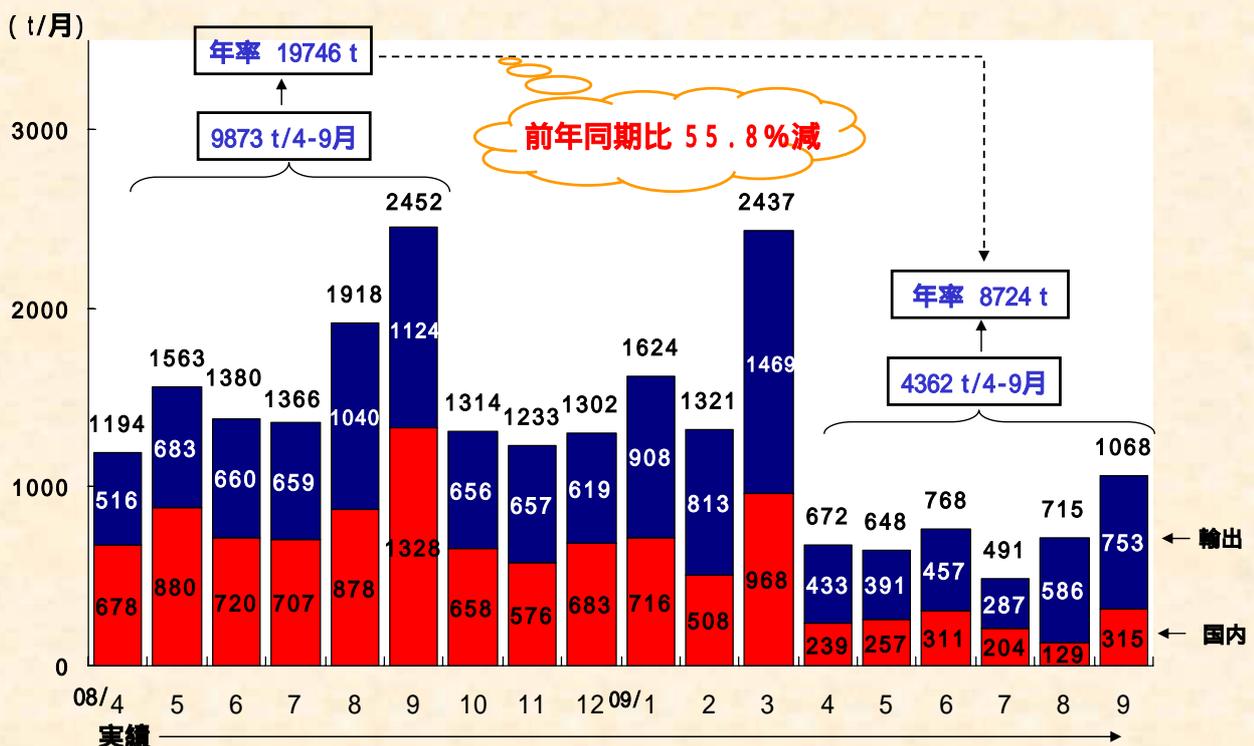
## <チタン事業>

国内展伸材市場	<p>世界経済の低迷によりプラント向け主体に内外のチタン需要が大幅に縮小し、在庫調整が継続</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>09/上期国内展伸材出荷量 4362t (前年同期比 56%)</p>
輸出航空機用展伸材市場	<p>航空旅客需要の低迷に加え、ボーイング社の度重なる納入遅れ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>在庫調整継続、チタン需要増加時期の遅れ</p>
鉄鋼添加材市場	<p>国内鉄鋼生産量回復に伴い、需要減退、市況悪化に底打ち</p>

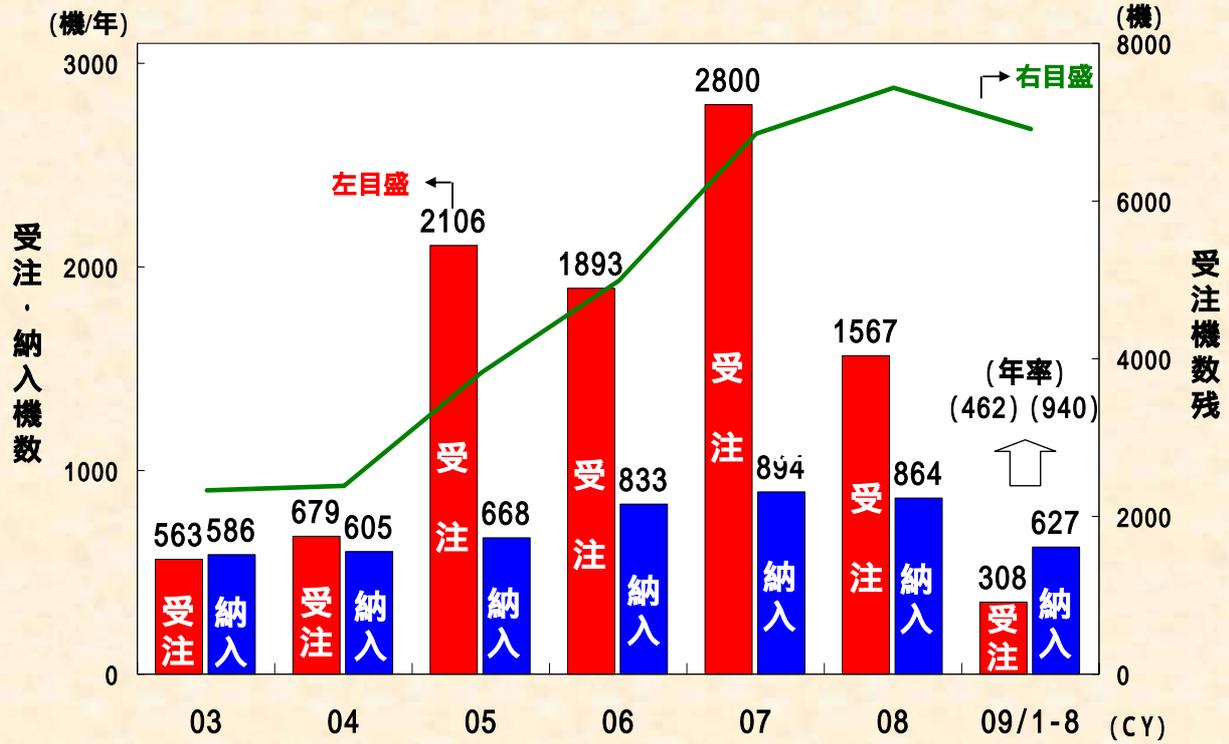
# 日本の展伸材出荷量 (年度別)



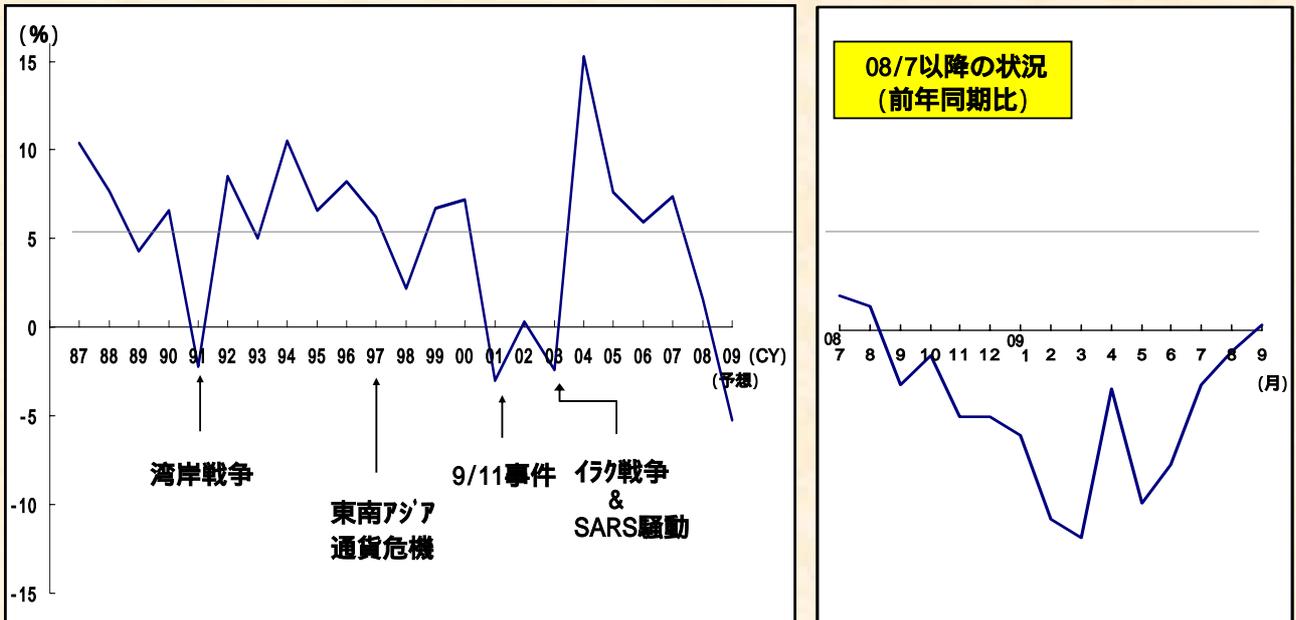
# 日本の展伸材出荷量 (月別)



## 民間航空機の受注・納入機数 (ボーイング+エアバス)



## 輸送量(有償旅客距離)の伸び率(対前年)



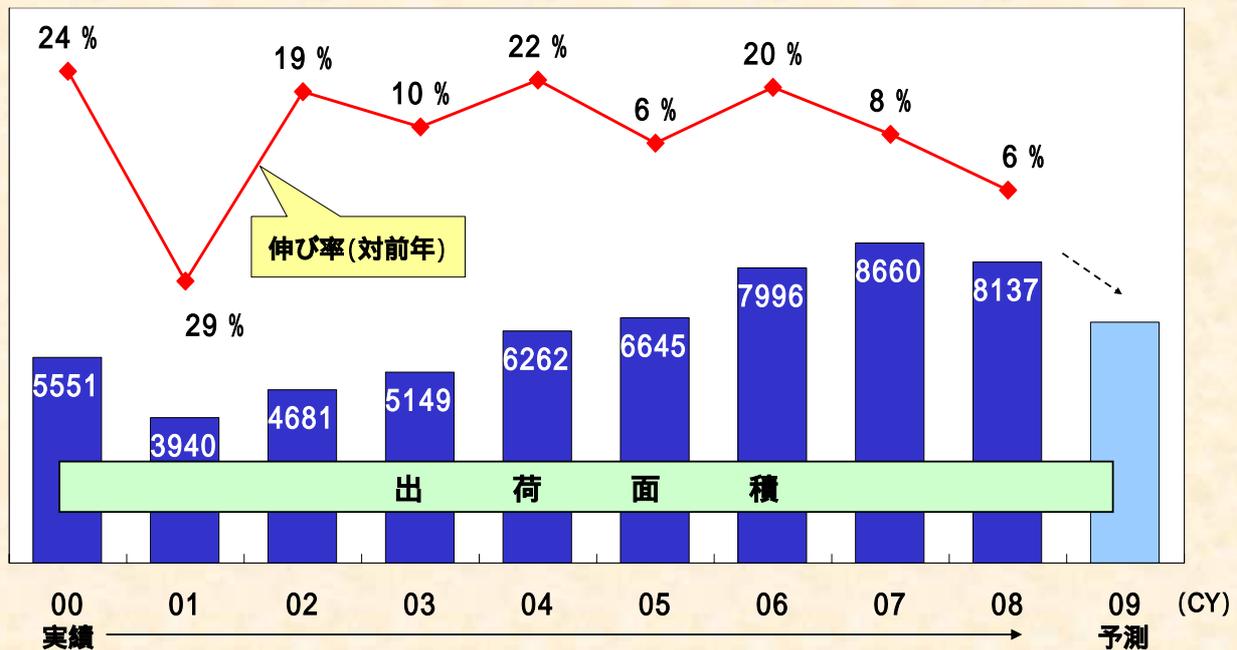
## 足元の市場環境

<半導体・高機能材料事業>

半導体市場	09/1～3月期を底に回復基調に転じるも、 08/上期までに比べると依然低い生産水準 ↓ ユーザーで多結晶シリコンの在庫調整継続 多結晶シリコン市場価格も反転には至らず
太陽電池市場	世界不況の影響で需要拡大のスピードが 鈍化する一方、供給増加により需給緩和 ↓ 太陽電池用多結晶シリコンも需給緩和 市況は軟化傾向

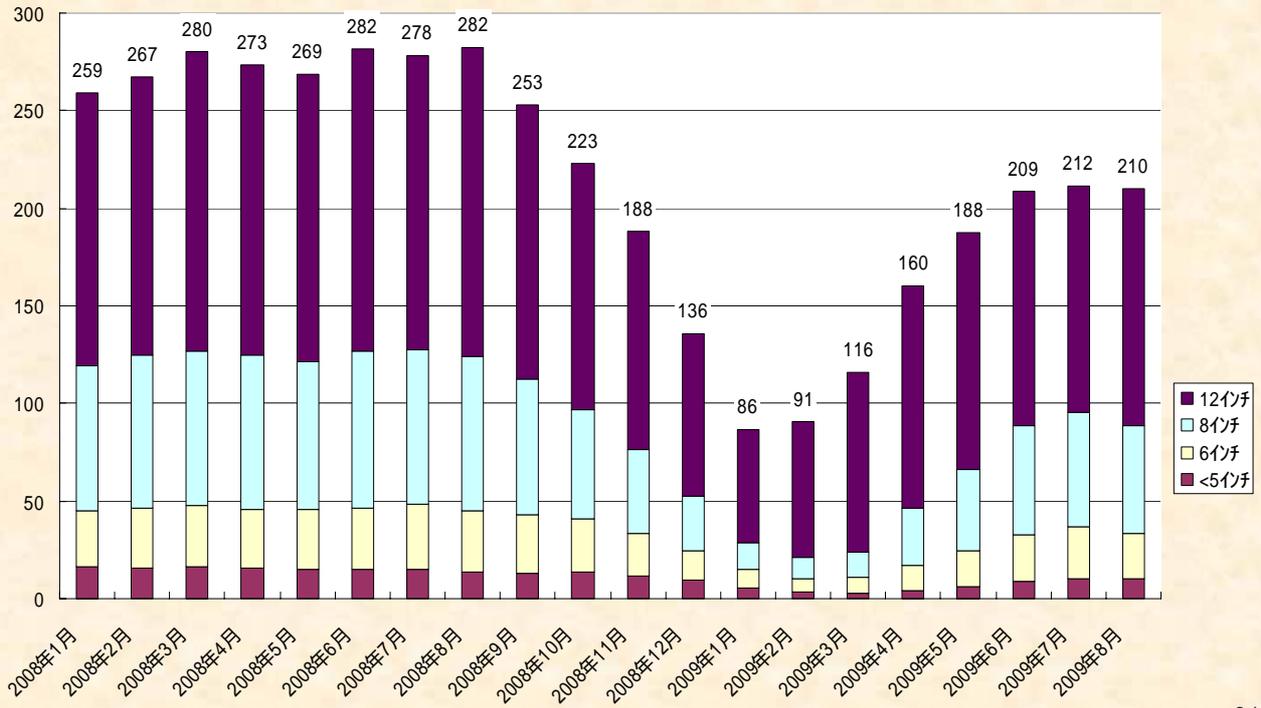
## シリコンウェ - ハ出荷面積(全世界)

(100万平方インチ/年)



# シリコンウェ - 八生産量月別推移(国内)

生産量(千m<sup>2</sup>)



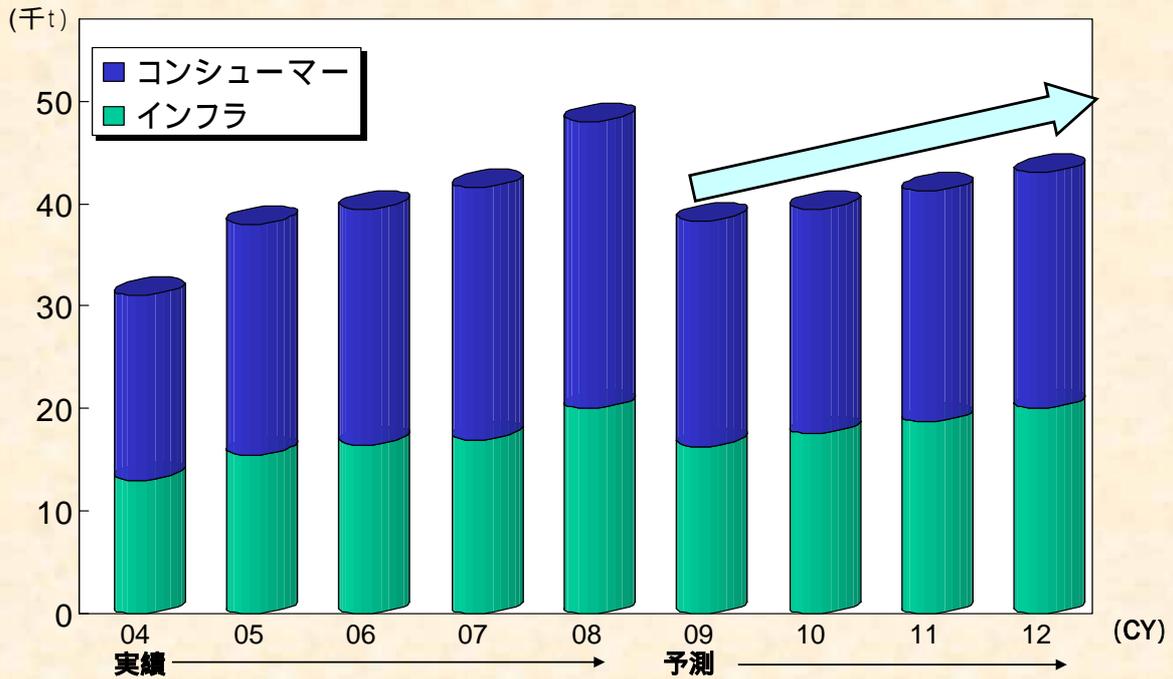
出典：経済産業省統計データより

# 中期市場環境の展望

# 中期市場環境の展望

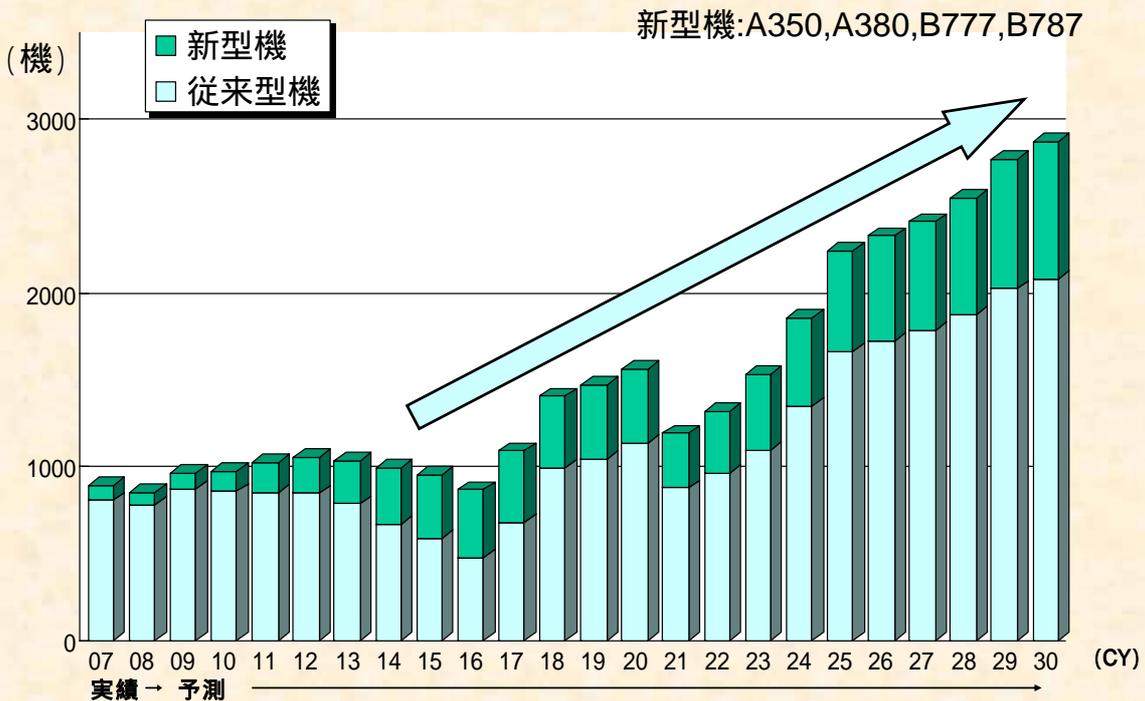
<p>チタン事業 民間需要</p> <p>航空機用需要</p>	<p>2010年から緩やかに回復傾向へ</p> <p>2011年から増加に転換</p>
<p>半導体・高機能材料事業</p>	<p>引き続き回復基調を辿り 2011年には2007年水準超へ</p>

## チタン民間需要(世界)



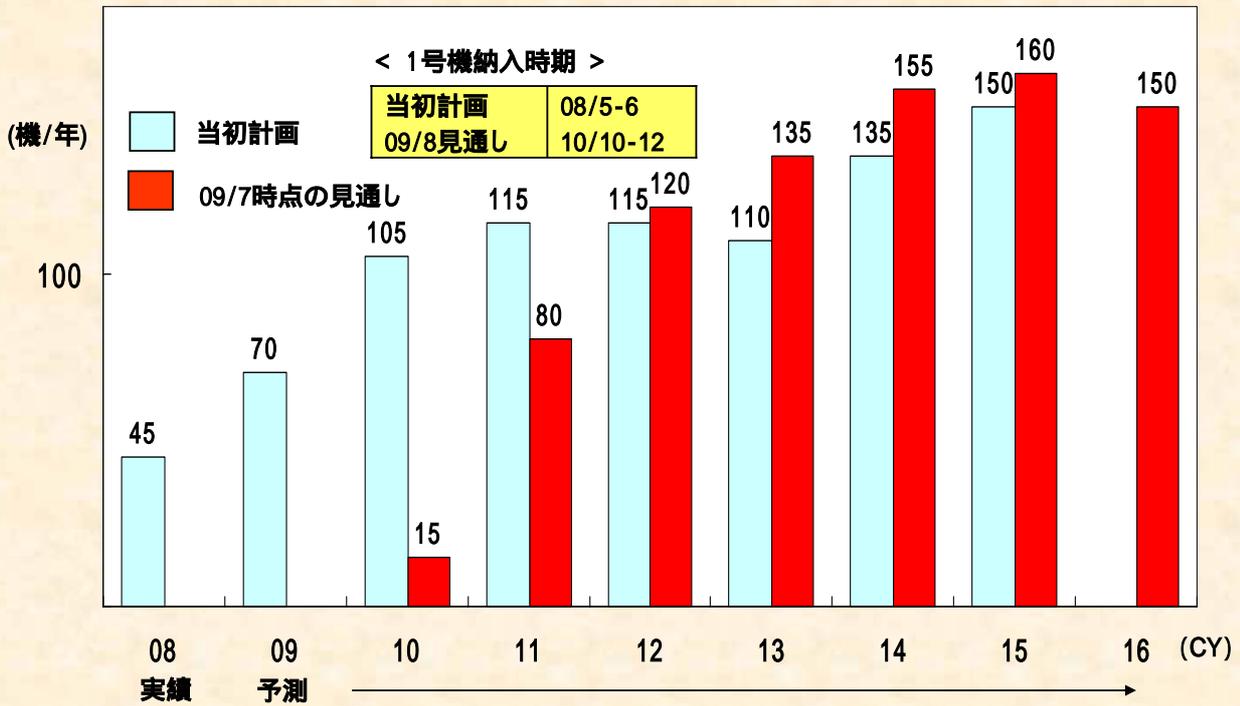
出典: ITAデータより

## 民間航空機デリバリー機数展望



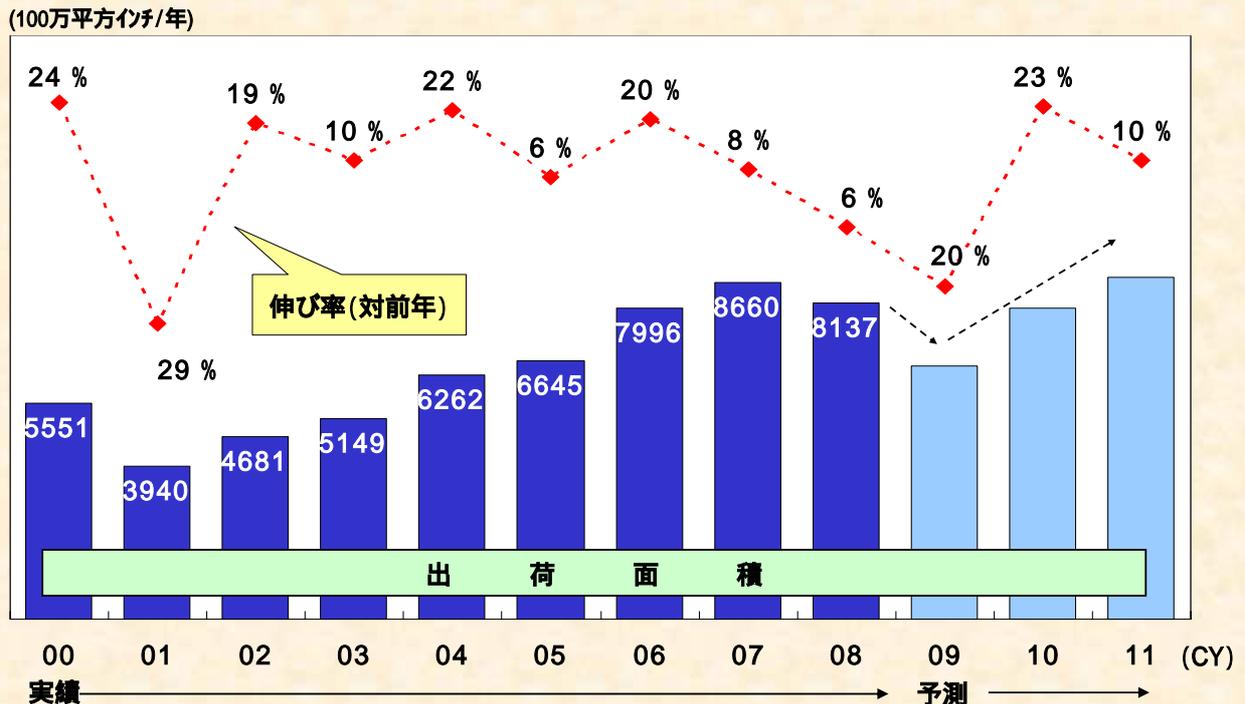
出典: Air Line Monitor より

## 「B787」のデリバリ-機数展望



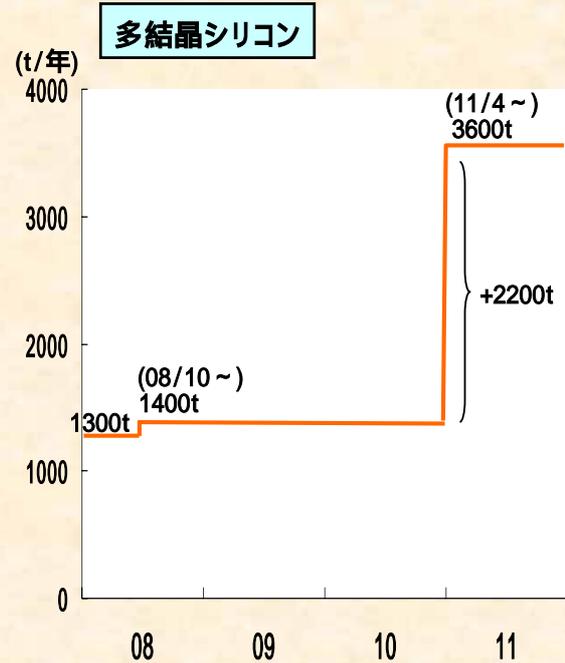
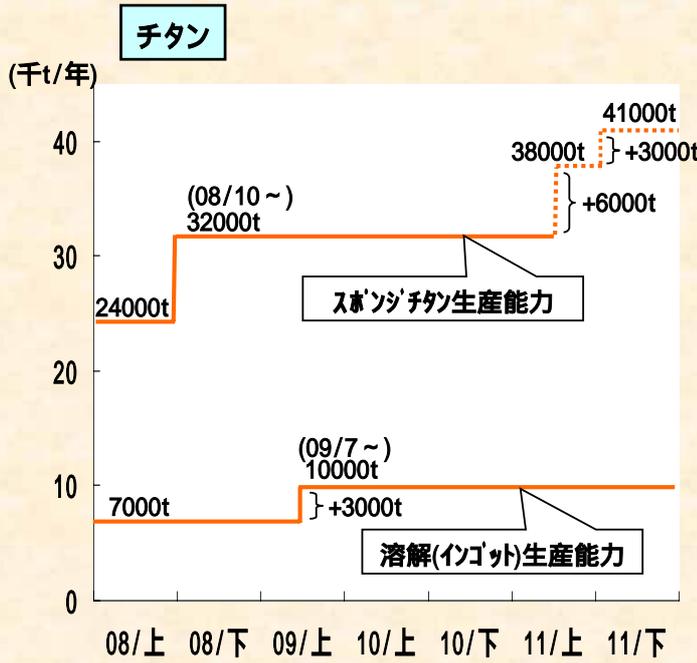
出典: Air Line Monitor より

## シリコンウェ - ハ出荷面積 (全世界)



出典: SEMIデータより

# 生産能力増強計画



# 終了

本資料は、金融商品取引上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、説明会の時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、不確定要素を含んでおります。このため、様々な要因により、実際に生じる結果が予測内容と異なる可能性があることをご承知下さい。本資料利用によって生じるいかなる結果につきましても、当社が責任を負うものではありません。